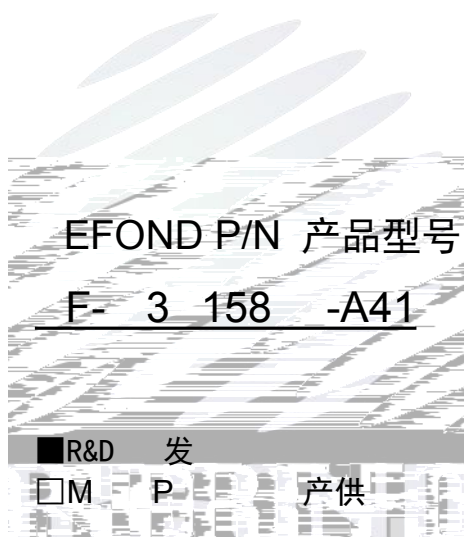


产品 书



C

1. D	产品介	
1.1 G	D 产品	
1.2 F	产品 H	
1.3 A	产品应	
1.4 P	D 封 尺寸	
1.5 P	P 产品参	
1.6	O C C 典型光学	
2. P	产品包	
2.1 P	包	
2.1.5 C	D 带尺寸	12
2.1.2	D 卷 尺寸	12
2.1.3 L	F	13
2.2 M	P 包	
2.3 C	B 包	
2.4	I A C 信 及 件	
2.5 C	F J D 失 判定 准	
3. M	I M	
3.1 M	I M 回	
4. H	P 产品使 事	
4.1 H	P 产品使 事	

产品介

产品

C LED , , P D :

3.2 1.25 1.1 .

产品为三光 LED, 光, 光和光封 , 产品尺寸:

3.2 1.25 1.1 。

产品 H

E .发光 度大

M M 于 SMT 和 工

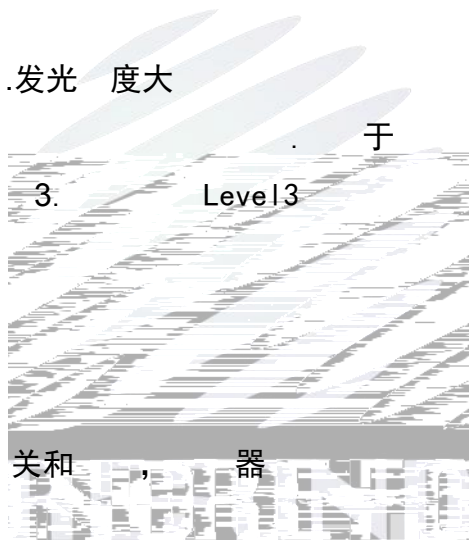
M :L 3. Level13

H . RoHS

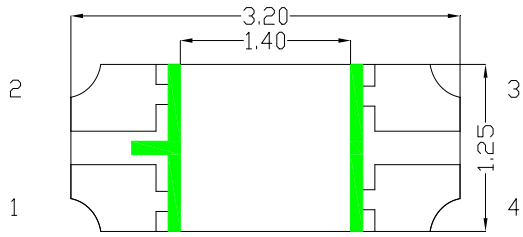
O .产品应

G .光学

.其他应 . 关和 , 器

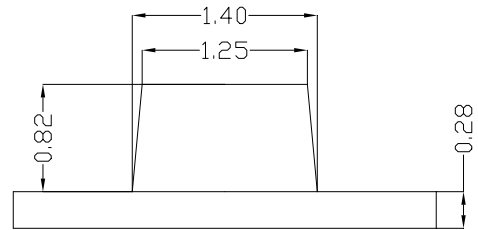


封 尺 寸



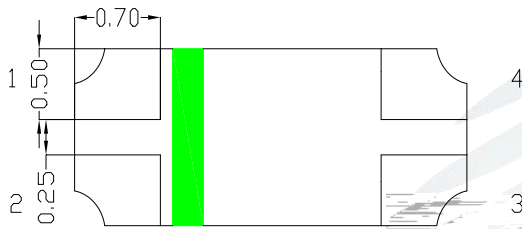
F .1-1

图



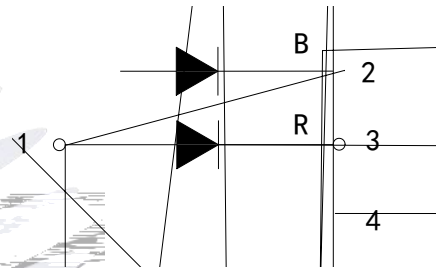
F .1-2

侧 图

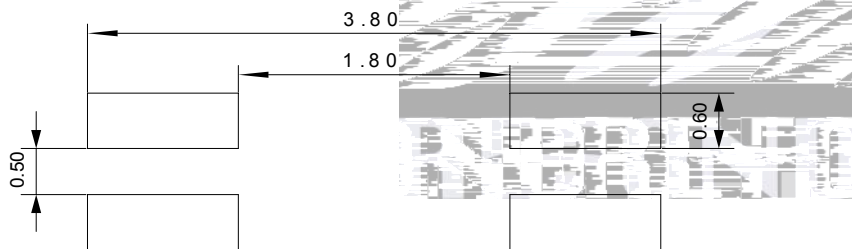


F .1-3 B

图



F .1-4 P



F .1-5

N 备 :

1. A . 尺寸 单位为

A ±0.2

. 别 外, 尺寸公差为±0.2

产品参

1-1 E / O C =25 C 与光学

I	C 件	号	C 代	M .	.	M .	单位			
				(小值)	(典型值)	(大值)				
H B 半 宽	I _F =20 A		G /	--	15	--				
			B	--	30	--				
			B	--	30	--				
F 向 压	I _F =20 A	F	1L	1.8	--	2.4				
			G	3E	3.0	--		3.4		
			B	3E	3.0	--		3.4		
D 主	I _F =20 A	G	F00	625	--	630				
			G00	630	--	635				
			D10	515	--	517.5				
			D20	517.5	--	520				
			E10	520	--	522.5				
			E20	522.5	--	525				
		B	D10	465	--	467.5				
			D20	467.5	--	470				
			E10	470	--	472.5				
			E20	472.5	--	475				
			D20	35	--	43				
			E00	43	--	65				
L 发 光 度	I _F =20 A	I	G	1A	330	--	430			
				1CG	430	--	560			
				1CL	560	--	700			
				1CM	700	--	900			
		B	1DM	60	--	90				
			1J	90	--	150				
			1A	150	--	200				
			A 发 光 度	I _F =20 A	2 1/2		--	140	--	
				=5	I		--	--	10	μA
			C 反 向	I _F =20 A	HJ-		--	--	450	°C/

N 备 : =5 F . =5 为 分 件。

1-2 A M =25 C 对 大值

P (参)	(号)	(值)			(单位)
			G	B	
P D (功)	P	48	68	68	
F C (向)	I _F	20			A
P F C O P (冲峰值)	I _{FP}	60			A
E D (HBM) ()	E D	1000			
O (作度)		-40 +85			
(储存度)		-40 +85			
J ()		95			

N 备 :

1. 1/10 D , 0.1

宽0.1ms, 占 1/10.

2. 0.1 以上 压 差±0.1V.

3. 2 . 以主 差±2nm.

4. 10%. 上 发光 度 允 公差±10%.

5. C . 使

功 不 定 大值。

6. A . 基于 丰

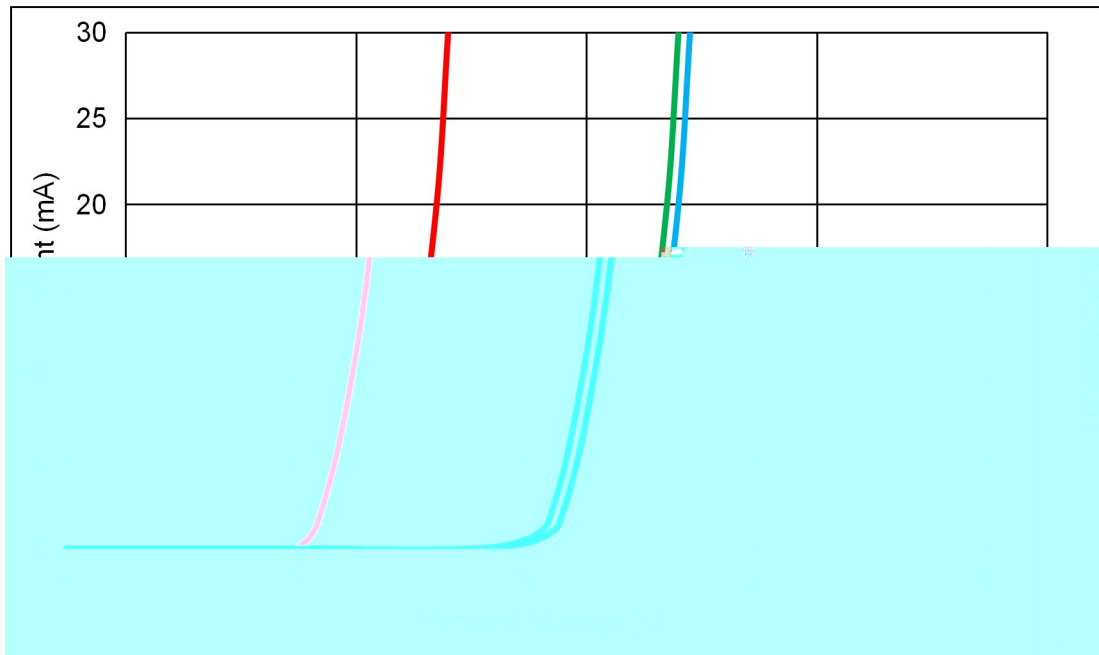
准 平台。

7. LED

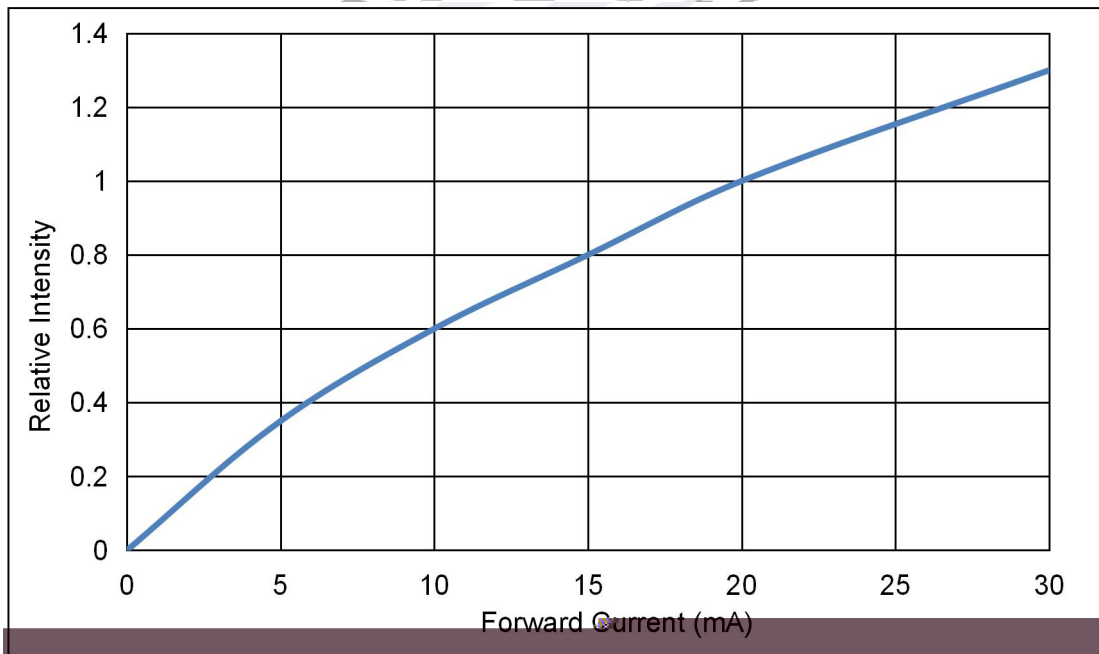
. LED使 大

件 定, 不 大值。

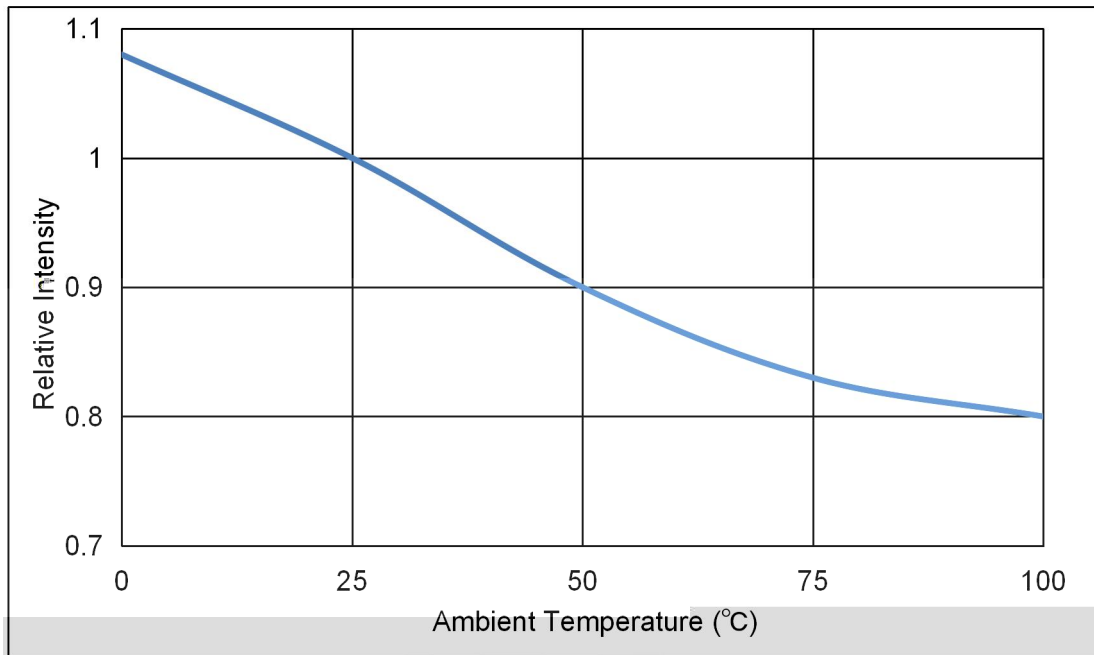
典型光学



F .1-6 F F C 伏安



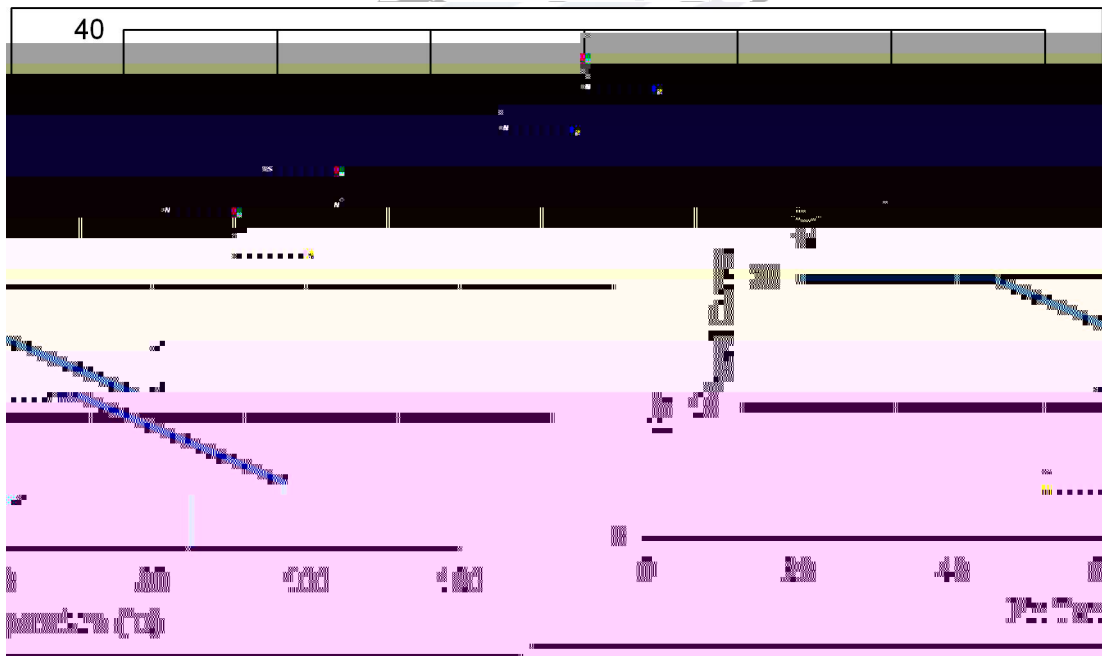
F .1-7 F C I 向 与 对光



F .1-8 P



I 度与 对光

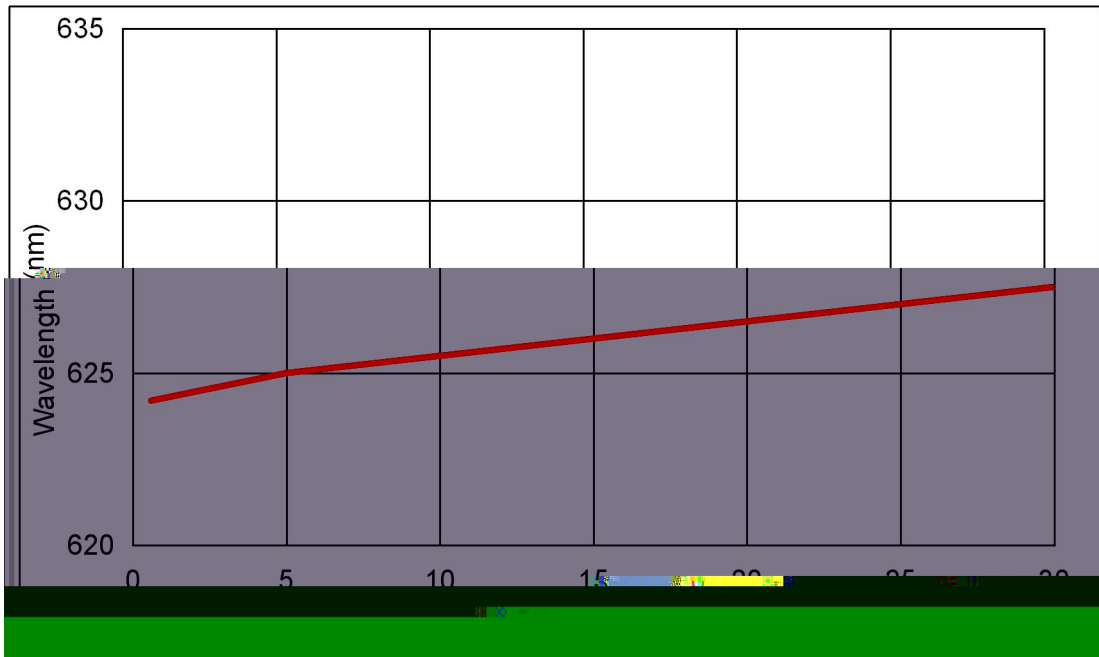


F .1-9 P

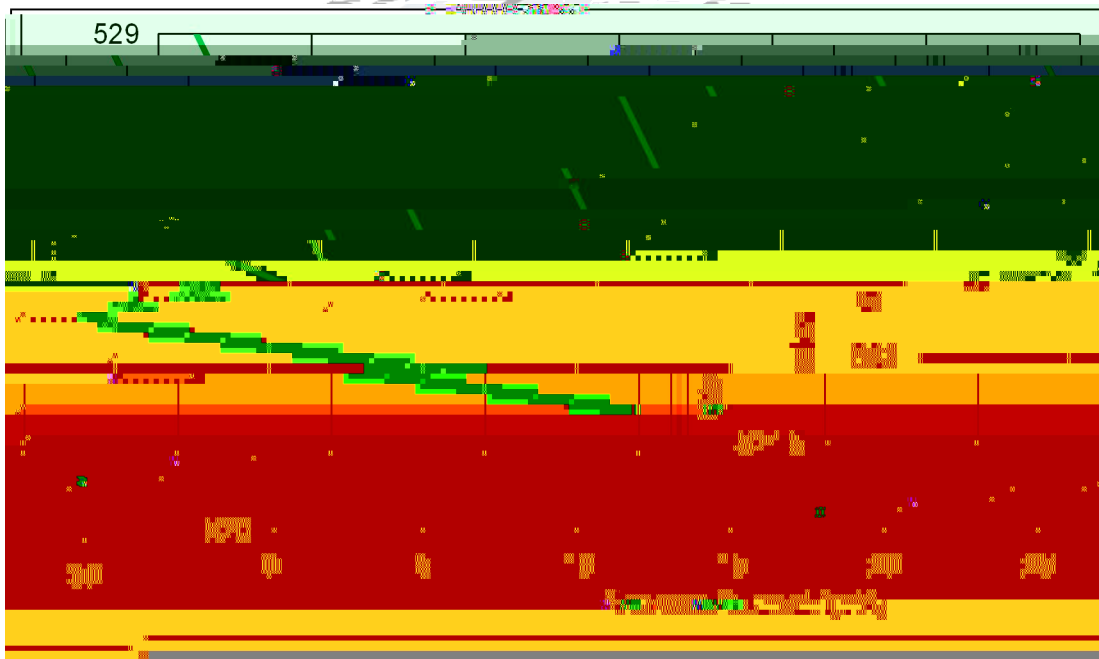
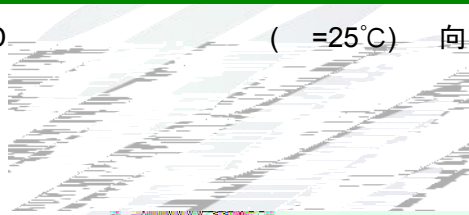
F

C

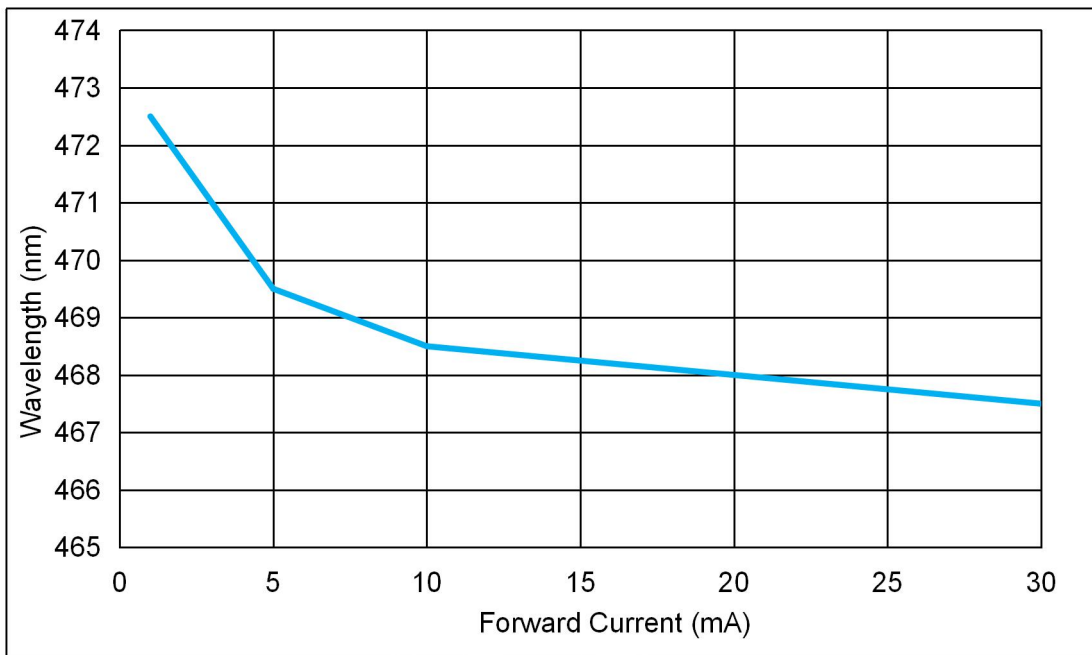
度与 向



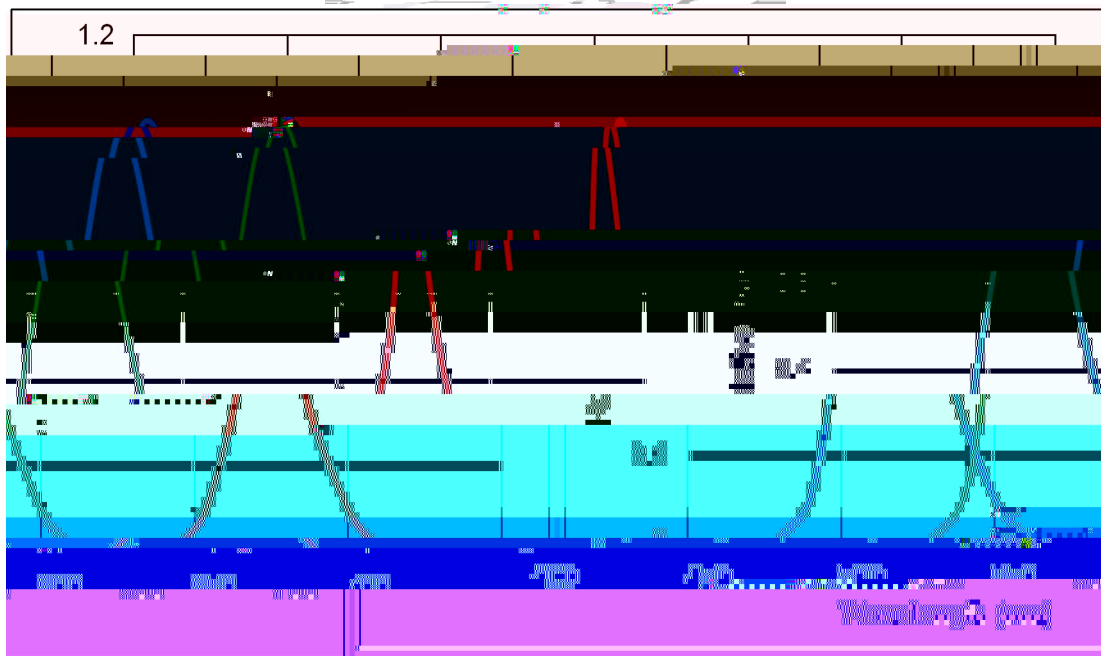
F .1-10 F C D (=25°C) 向 与主 关 (光)



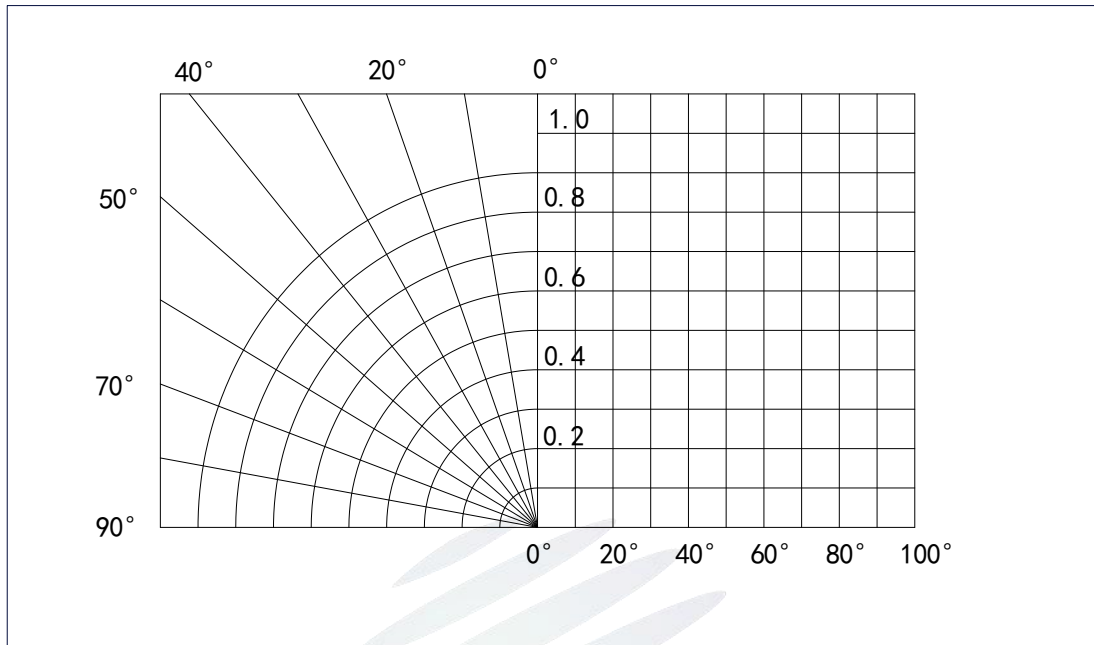
F .1-11 F C D (=25) 向 与主 关 (光)



F .1-12 F C D (=25) 向 与主 关 (光)



F .1-13 I (=25) 对光 与 关



F .1-14 D

射





产品包

包

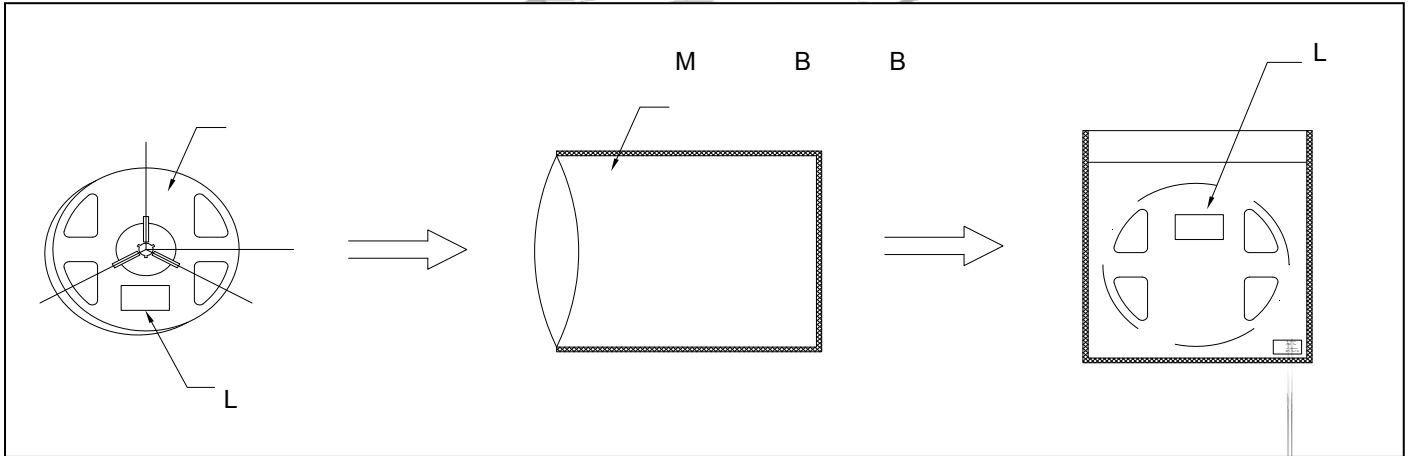


2.1.3 L F

PART NO:	
SPEC NO:	
LOT NO	
BIN CODE:	
Φ:	XY:
VF:	WLD:
	QTY:
	DATE:

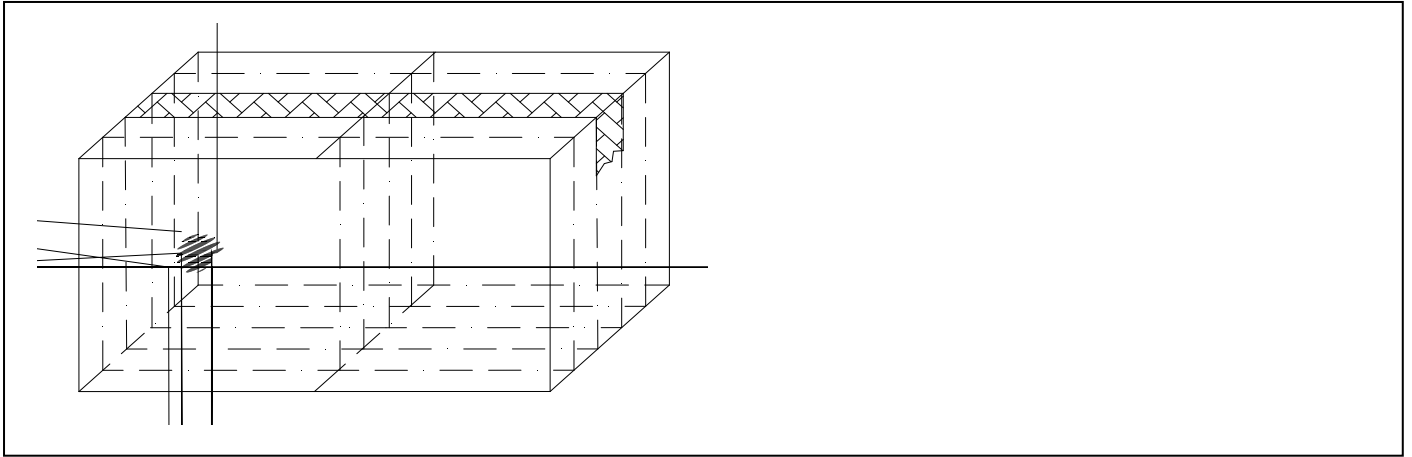
	2-2 P	参
PA NO.	P N	品名
PEC NO.	N	
LO NO.	L N	号
BIN CODE	B C	参代
	L	光
	C	B 区
F	F	向压
LD		代
Q	P Q	
DA E	M D	产

F .2-3 L F



F .2-4 M P 包

包



F .2-5 C B 包

信 及 件

2-3

I A C 信

及 件

I	参 准	C 件	Q	A / /
回	JE D22-B106	:260°C =10	2	22P . 0/1
度 C	JE D22-A104	100°C 30 5 -40°C 30	100	22P . 0/1
冷 冲击	JE D22-A106	-40°C 15 100°C 15	300	22P . 0/1
H 保存	JE D22-A103	:100°C	1000 .	22P . 0/1
L 低 保存	JE D22-A119	:-40°C	1000 .	22P . 0/1
L 常	JE D22-A108	=25°C If=20 A	1000 .	22P . 0/1

失 判 定 准

I	2-4 C	F J	D	失 判 定 准	
				C	F J
	号		件	M . 小	M . 大
F 向 压	F		$I_F=20$ A	-	. .L*) 1.1
C	I		$\epsilon=5$	-	. .L*) 2.0

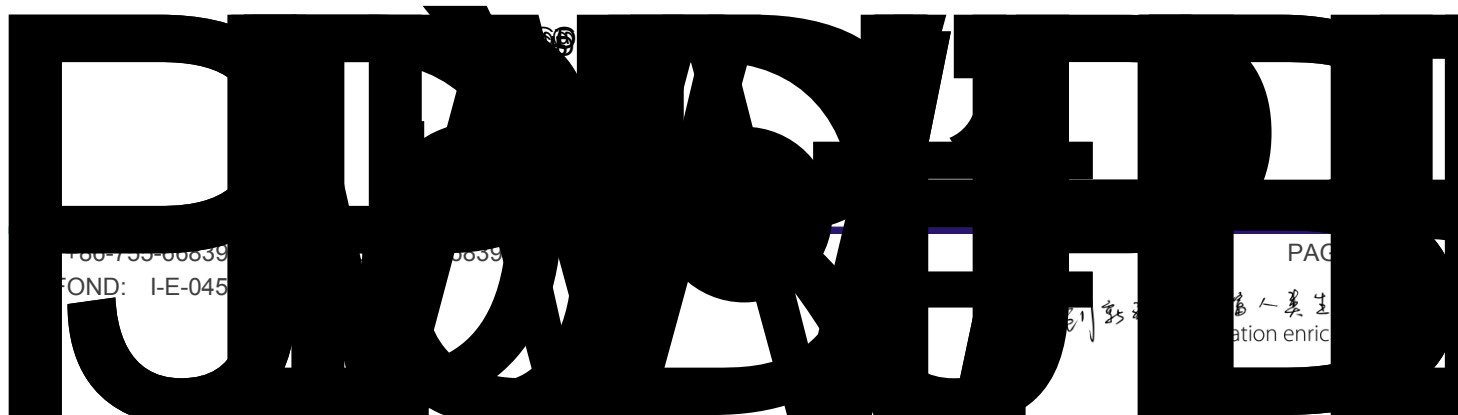
L F
光



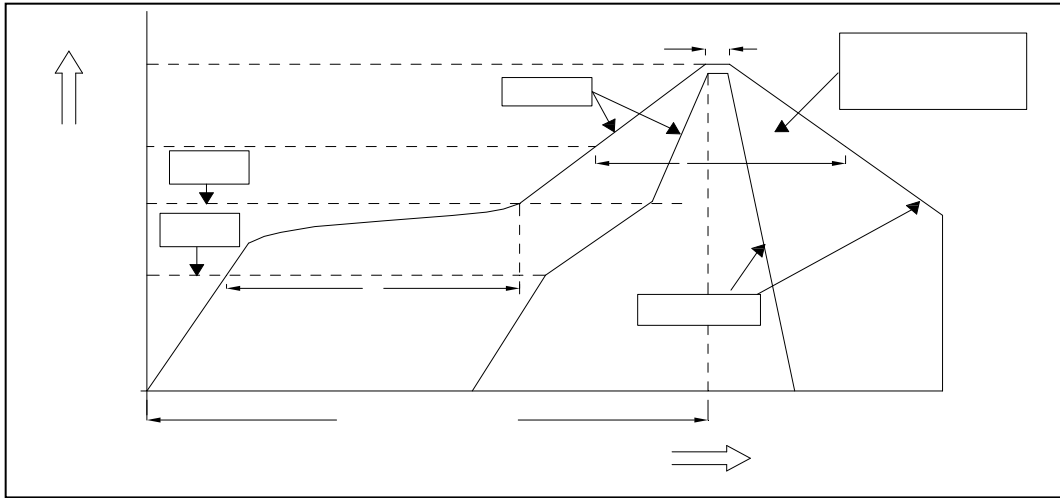
REFOND 瑞豐光電

X 瑞豐光電 瑞豐光電

瑞豐光電



回



F .3-1 M I M 回

3-1 P 参

A	平均升 度 (P)	3 C/ M 3 C/
P	: 低 度 ()	150 C
P	: M : 度 ()	200 C
P	: : ()	60 - 120 60 -120
	: : 度 (L)	217 C
	: : (L)	60 - 150 60 -150
P /C	:峰值 / 分 度 (P)	260 C
	峰值分 度: ()	多10 M 10
H	5 ° C (P) 与实 峰值 度 (P)	多30 M 30
	差 5 C 以内 保	
C	度	6 C/ M 6 C/
N	25 C 25 C 升 峰值 度	多8分 M 8

注意：

(1) 在焊接过程中，LED 不可以两回，两回如 24 小时，LED 可于吸坏。

(2) LED 不在受压力体。

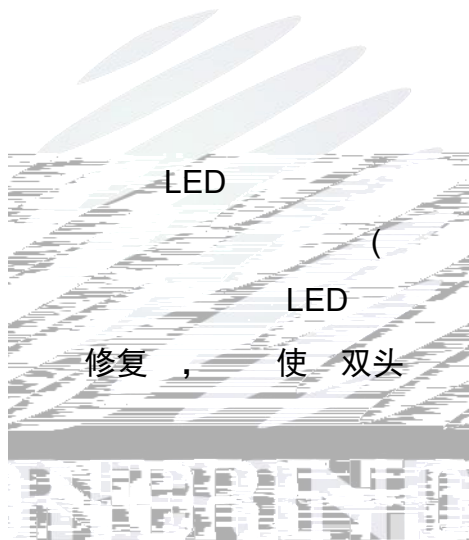
3.1.1 焊接

(1) 温度小于 300°C，不可 3。

(2) 工 只可 一。

3.1.2 修复

LED 修复，使双头，且事先应 会不
LED 回 后不应 修复，
会 坏 LED。



3.1.3 C 事

(1) C () PCB. A ,
.LED 不 在 PCB 上， 之后，也不 。

(2) D .D .回 之后冷却 中，不
对 实加外力，也不 动，回 后，不 剧冷却 。

产品使用

产品使用

(1) LED
LED

.LED 工作环境及与 LED
一个建设, 不作任何品保。

中元及化合物 份不可 100PPM 只

(2) I

LED, B
900PPM, C
B C

1500PPM.
.为了外入LED内以
境及套件, 单一元含小于900PPM, 单一元含
与元含小于1500PPM. 只一个建设, 不作任何品保。

LED,
900PPM,
LED 伤, 处
小于900PPM, 元

(3) OC (



.A LED,
.应套件中发会到LED内, 在产光
子及件下, 会导LED变, 严光, 前了套件够免产些。
丰反对使任何对LED器件可害, 不些已实了
仅仅害。对定和使境, 丰建对和容。
在LED候, 不使产发体剂。

(4) I , LED
 LED.I , ,
 , ON OFF.I
 LED, LED , LED
 不 定 大值,同 , 使 保 , 否则, 小 压变化将会 大
 变化,可 导 产品 。 保 只 在 启 关 候出 向 压 变化,不
 加反压,否则会 坏 LED。

(5) D
 C , ,C .P
 LED .LED 容 因为 发 和 境
 度 变 变, 度升 会 低 LED 发光 , 响发光 , 以在 应充分
 。

(6) 储存



C		度	H 度		
储存	B O A 包前	B	≤30°C	≤75%	1 F D 一年内
	A O A 包后	B	≤30°C	≤60%	168 168小
B			60±5°C	-	≥24 大于24小

(7) I LED
 60 5 24 .如 干 剂 包 失 , 产品不 合以上
 储存 件, 包后 , 件: 60±5°C, 大于 24 小 。
 I , .如 包
 , 售人员协助处 。

(8) ; LED E - D (E D)
 E O (EO). 像其他 半导体 子器件一 , LED 对 击 常 ,
 做好 。

(9) O , .其它 事 参 丰
 关 。



